



**HAL**  
open science

## Evaluation de technologies de substrats céramiques sous des cyclages en température de forte amplitude

Laurent Dupont, Stéphane Lefebvre, Zoubir Khatir, Serge Bontemps, Régis Meuret

► **To cite this version:**

Laurent Dupont, Stéphane Lefebvre, Zoubir Khatir, Serge Bontemps, Régis Meuret. Evaluation de technologies de substrats céramiques sous des cyclages en température de forte amplitude. EPF 2006 - Electronique de Puissance du Futur, Jul 2006, Grenoble, France. 6p. hal-01704147

**HAL Id: hal-01704147**

**<https://hal.science/hal-01704147>**

Submitted on 8 Feb 2018

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

# Evaluation de technologies de substrats céramiques sous des cyclages en température de forte amplitude

Laurent Dupont<sup>(1,2)</sup>, Stéphane Lefebvre<sup>(2)</sup>, Zoubir Khatir<sup>(1)</sup>,  
Serge Bontemps<sup>(3)</sup>, Régis Meuret<sup>(4)</sup>

(1)INRETS LTN, 2 av. du Général Malleret-Joinville, F94114 Arcueil

(2)SATIE, UMR CNRS 8029, ENS de Cachan 61 Av. du président Wilson F94235 Cachan

(3)APT Europe, Chemin de Magret, 33700 Merignac

(4)HISPANO-SUIZA, Rond Point René Ravaut– Réau, F77550 Moissy-Cramayel

*Résumé : Cette étude cherche à évaluer le comportement de substrats céramiques, utilisés pour la réalisation de modules de puissance, pour des applications aéronautiques, à haute température, et sous des cycles de température de forte amplitude. L'article présente les résultats expérimentaux obtenus sur des substrats céramiques de différentes technologies. Plusieurs véhicules de test ont été réalisés par la société APT Europe. Ils sont composés de différents substrats céramiques, assemblés par brasage sur des semelles AlSiC, dont des DCB AlN et Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, ainsi que des solutions de technologie AMB comme le DAB (aluminium sur céramique AlN) ou des substrats Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>. Cet article montre les modes de défaillances, et compare les différentes technologies dans le but d'identifier les principaux facteurs permettant d'améliorer la durée de vie des assemblages de puissance dans des environnements thermiques sévères.*

## I. INTRODUCTION

Dans différents domaines d'applications (aéronautique, forage, automobile...), nous pouvons observer une augmentation de la demande pour des dispositifs d'électronique de puissance adaptés à un fonctionnement à haute température. Dans ces domaines d'applications, les composants et l'assemblage peuvent subir des contraintes environnementales sévères. Notamment pour des applications avionique, le convertisseur peut être placé sur le réacteur conduisant, dans le pire des cas, à des cycles thermiques entre -55°C et +200°C avec des variations de température de l'ordre de  $\pm 10^\circ\text{C}/\text{mn}$ . Afin d'évaluer le possible fonctionnement des assemblages de puissance dans un environnement à haute température, et sa fiabilité lors de cyclage thermique de grande amplitude, des essais de cyclage thermique ont été effectués sur différents véhicules de test. Ces véhicules de test, réalisés par la société APT Europe, se composent de différents substrats céramiques brasés sur des semelles AlSiC. Les résultats expérimentaux doivent permettre d'identifier les modes de défaillances, et nous aider à proposer des solutions afin d'améliorer la durée de vie des modules de puissance, en accord avec le profil de mission imposé. De plus, nous avons également pour objectif d'identifier les principaux facteurs susceptibles d'accroître la durée de vie des modules de puissance dans un environnement aussi sévère que celui présenté ci-dessus. Cet article se focalise sur les modes de défaillances observés lors de cycles thermiques de grande amplitude à haute température et plus précisément, sur la fracture conchoïdale de la céramique sous les métallisations en cuivre des substrats DCB, ainsi que la délamination de la brasure entre substrat céramique et semelle AlSiC.

## II. PRESENTATION DES VEHICULES DE TEST

Afin de minimiser les différences entre les coefficients de dilatation thermiques (CDT), entre les substrats céramiques et la semelle, les véhicules de test sont tous assemblés sur une semelle AlSiC. Les substrats étudiés sont brasés sur la semelle avec le même alliage haute température ( $T_{\text{liquidus}} > 290^\circ\text{C}$ ). Onze véhicules de test, avec des substrats de

technologies différentes, ont été réalisés par APT Europe puis intégrés dans le plan d'expérimentation :

- DCB (Direct Copper Bonding) sur céramique Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> : 5 véhicules de test différents dont les céramiques et les métallisations, avec ou sans dimples, sont de différentes épaisseurs.
- DCB sur céramique AlN : 4 véhicules de test dont les métallisations en cuivre, avec et sans dimples, sont de différentes épaisseurs.
- AMB (Active Metal Brazing) sur céramique Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> : un véhicule de test avec une épaisseur de cuivre de 400 $\mu\text{m}$ .
- DAB (Direct Aluminium Bonding) sur céramique AlN : un véhicule de test avec une métallisation en aluminium.

Le tableau 1 présente les principales caractéristiques des différents véhicules de test (VT). Le tableau 2 fait la synthèse des propriétés mécaniques et thermiques des matériaux constituant les différents échantillons. La figure 1 présente trois des différents véhicules de test.

## III. PROTOCOLES DE TEST :

Dans le but d'évaluer l'aptitude d'un l'assemblage de puissance à fonctionner dans un environnement à haute température d'une part, et d'autre part, sa durée de vie lorsqu'il est soumis à des cycles thermiques importants, des cyclages thermiques ont été appliqués en adéquation avec le profil de mission de l'application. Le profil thermique imposé aux véhicules de test est présenté ci-après, avec une durée par cycle d'environ 2 heures, et des taux de variations de la température de l'ordre de 12°C/mn. La température évolue entre -30°C et +180°C avec une durée de palier de 30mn afin de prendre en compte le phénomène de fluage de la brasure à température constante. Les tests ont été réalisés dans une enceinte climatique dans les locaux du LTN à l'INRETS. La figure 2 montre l'implantation des véhicules de test dans l'enceinte climatique, ainsi que la vérification de l'homogénéité de la température, qui est relevée à l'aide de six thermocouples implantés dans les semelles de quelques un des véhicules de test.

Les cycles thermiques, présentés dans la figure 3 (variation de la température entre -30°C et +180°C à  $\pm 12^\circ\text{C}/\text{mn}$  avec

des paliers de 30mm), sont appliqués simultanément à l'ensemble des véhicules de test. Le cyclage thermique est périodiquement interrompu afin de mesurer les indicateurs de vieillissement permettant de détecter l'apparition des modes de défaillance. Ainsi, l'évaluation du vieillissement des brasures est réalisée grâce à l'analyse par microscopie

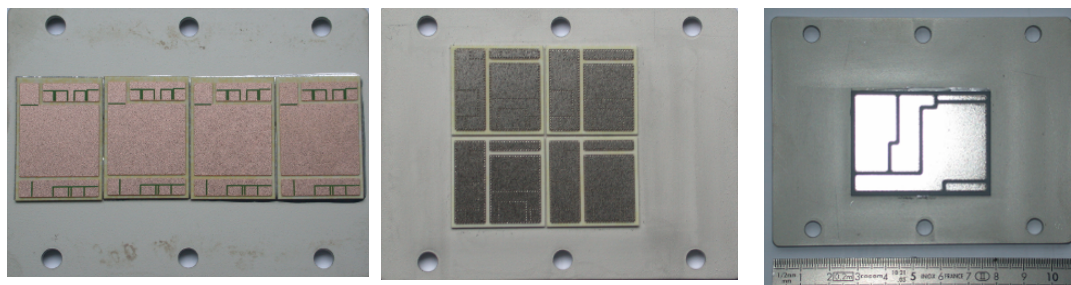
acoustique, avant d'entreprendre le cyclage, puis régulièrement au cours du test. L'intégrité des substrats céramiques a été évaluée par une mesure de la capacité des substrats céramiques (Figure 4) afin de détecter le décollement de la métallisation, tel que décrit dans [1,3].

Tableau 1: Véhicules de test.

Véhicule de test	Epaisseur des métallisations	Nombre de substrats	Nature de la céramique	Géométrie de la céramique	
				Epaisseur ( $\mu\text{m}$ )	Surface ( $\text{cm}^2$ )
VT 1	Cu : 300 $\mu\text{m}$	4	$\text{Al}_2\text{O}_3$	380	2,54×3,70
VT 2	Cu : 300 $\mu\text{m}$ barrière Ni avec <b>Dimples</b>	4	$\text{Al}_2\text{O}_3$	380	2,54×2,70
VT 3	Cu : 300 $\mu\text{m}$	4	AlN	635	2,54×3,70
VT 4	Cu : 300 $\mu\text{m}$	6	AlN	635	3,00×1,15
VT 5	Cu : 400 $\mu\text{m}$ barrière Ni	1	<b><math>\text{Si}_3\text{N}_4</math></b>	320	3,80×5,10
VT 6	<b>Al</b> : 400 $\mu\text{m}$ barrière Ni	2	AlN	635	3,80×5,80
VT 7	Cu : 127 $\mu\text{m}$	8	AlN	635	2,54×2,54
VT 8	Cu : 200 $\mu\text{m}$	8	AlN	635	2,54×2,54
VT 9	Cu : 127 $\mu\text{m}$	8	$\text{Al}_2\text{O}_3$	380	2,54×2,54
VT 10	Cu : 200 $\mu\text{m}$	8	$\text{Al}_2\text{O}_3$	380	2,54×2,54
VT 11	Cu : 127 $\mu\text{m}$	8	$\text{Al}_2\text{O}_3$	500	2,54×2,54

Tableau 2: Principales propriétés physiques des matériaux constituant les véhicules de test.

	AlN	$\text{Al}_2\text{O}_3$	$\text{Si}_3\text{N}_4$	Cu	Al	AlSiC	Brasure haute température
Conductivité thermique (W/m.K)	170 – 260	20 – 30	60	390	240	170 – 200	23
CDT ( $10^{-6}/^\circ\text{C}$ )	4,2 – 4,5	7,5 – 8,1	2 – 3,4	16	23	6,5 – 8	29
Module de Young (GPa)	300 – 310	300 – 380	300	130	70	200 - 250	$24.1-28 \times 10^{-3} \text{ T}(^\circ\text{C})$
Limite à la rupture (MPa)	300 – 500	250 – 300	700				
Seuil de plasticité (MPa)				70	20		



VT1 : DCB  $\text{Al}_2\text{O}_3$  0,38mm ;  
Cu 300 $\mu\text{m}$  sans dimples.

VT2 : DCB  $\text{Al}_2\text{O}_3$  0,38mm ;  
Cu 300 $\mu\text{m}$  avec dimples.

VT5 : AMB  $\text{Si}_3\text{N}_4$

Figure 1 : Photographies de quelques véhicules de test.

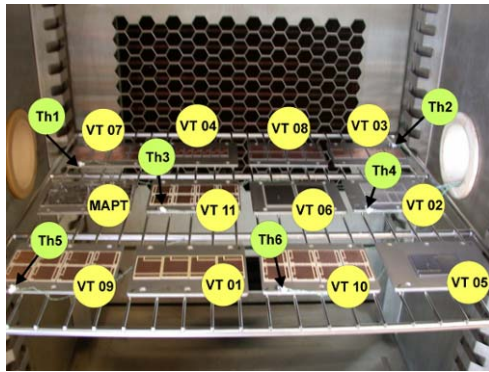


Figure 2 : Implantation des véhicules de test dans l'enceinte

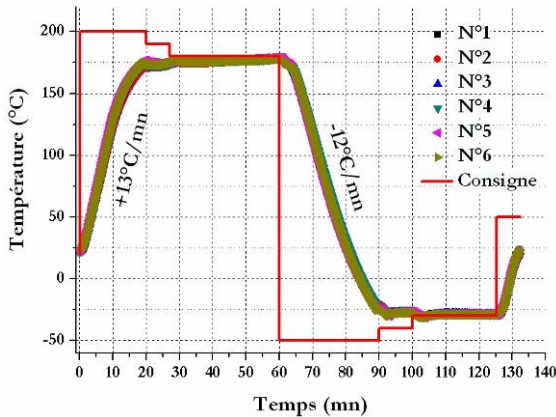


Figure 3 : Température de référence, profil de température et contrôle de l'uniformité de la température dans l'enceinte

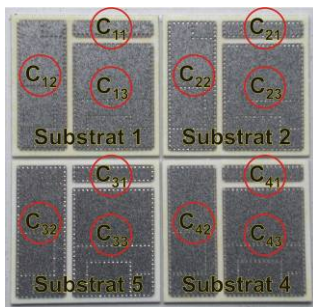
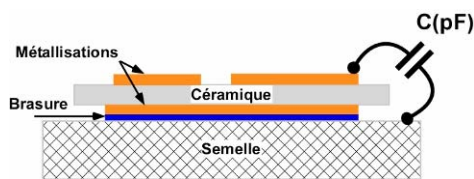


Figure 4 : Evaluation de l'intégrité du substrat céramique par mesure de la capacité, et zones d'évaluation des capacités pour le VT2.

#### IV. DEFAILLANCE DE LA CERAMIQUE :

Les différences des coefficients de dilatation thermique, entre les métallisations (Al, Cu) et les céramiques (AlN, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>), conduit à des contraintes mécaniques dans la céramique. De plus, en raison du durcissement du cuivre des métallisations des DCB, ces contraintes mécaniques augmentent régulièrement dans la céramique au cours de la répétition des cycles thermiques. Lorsque le niveau de contraintes atteint la limite de rupture de la céramique, une fracture conchoïdale apparaît dans la céramique comme le montre la figure 5.

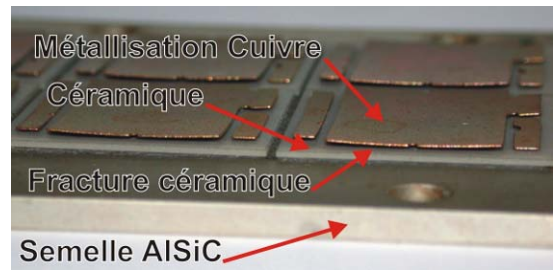


Figure 5 : Fracture conchoïdale dans la céramique après 500 cycles (VT 8).

La figure 6 montre la variation relative de la capacité mesurée sur l'une des métallisations du véhicule de test N°7, au cours du cyclage thermique. Le nombre de cycles nécessaire pour observer la fracture (Nf), estimé à partir de la mesure de la capacité utilisée comme indicateur de défaillance, est présenté dans le tableau 3 pour l'ensemble des véhicules de test.

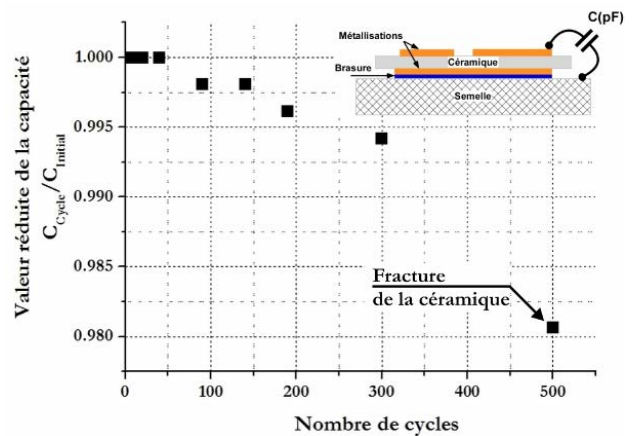


Figure 6 : Variation de la valeur réduite de la capacité durant la répétition des cycles thermiques (VT 7).

Tableau 3: Durée de vie de la céramique relevée lors de l'apparition de la fracture conchoïdale.

VT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cycles (Nf)	> 90 < 140	> 700	> 20 < 40	> 20 < 40	> 700	> 700	> 300 < 500	> 40 < 90	> 700	> 700	> 700

Les résultats montrent clairement qu'une épaisseur élevée de métallisation n'est pas adaptée pour des contraintes thermiques aussi sévères que celles imposées ici. En effet, la durée de vie du substrat DCB AlN, avec 300µm d'épaisseur de cuivre, est inférieure à 40 cycles. Considérant la même nature de céramique (AlN), nous observons clairement qu'une réduction de l'épaisseur du cuivre permet une augmentation significative de la durée de vie. Cette première conclusion confirme les résultats déjà obtenus par Curamik [4]. Les résultats sont illustrés à la figure 7 pour les véhicules de test N°3 et 4 (300µm d'épaisseur de cuivre), le VT8 (200µm d'épaisseur de cuivre) et le VT7 (127µm d'épaisseur de cuivre). Pour ce dernier cas, la durée de vie peut être améliorée d'un facteur proche de dix (entre 300 et 500 cycles) en comparaison avec les dispositifs présentant une métallisation de 300µm d'épaisseur.



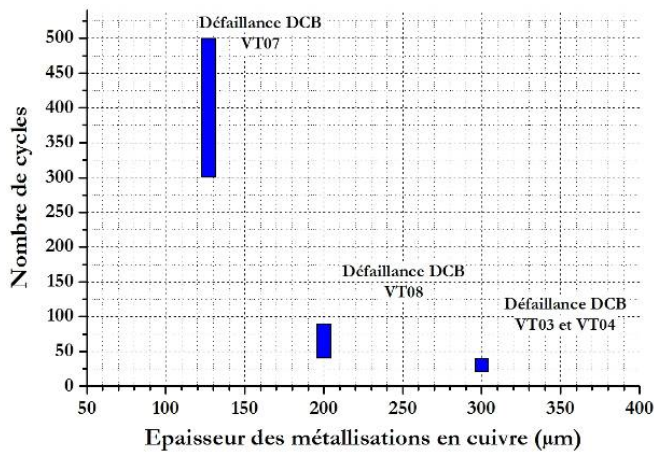


Figure 7 : Influence de l'épaisseur de la métallisation sur la durée de vie du substrat DCB.

Quelques un des véhicules de test ne présentent toujours pas de défaillance après plus de 700 cycles (arrêt provisoire des tests). C'est le cas pour le DCB présentant des métallisations en cuivre avec dimples [4], ainsi que pour les deux substrats AMB, le DAB et le substrat céramique  $\text{Si}_3\text{N}_4$ .

Dans le but d'accroître la durée de vie des substrats céramiques DCB, les contraintes mécaniques dans la céramique, induites par le durcissement du cuivre des métallisations lors de la répétition des cycles de température, doivent être diminuées, et on doit utiliser des céramiques présentant une résistance mécanique plus élevée.

La présence de dimples, à la périphérie des métallisations, permet de réduire les contraintes mécaniques induites dans la céramique. Comme présenté pour le VT2, l'effet des dimples est significatif, avec l'absence de défaillance relevée après plus de 700 cycles thermiques de forte amplitude. Les dimples agissent ainsi comme une réduction localisée de l'épaisseur de cuivre.

Les substrats AMB DAB sur céramique  $\text{AlN}$  (VT8) semblent être là aussi une solution technologique très intéressante dans le cas de sollicitations thermiques très contraignantes. Malgré un CDT élevé ( $23\mu\text{m}/\text{mK}$ ), l'aluminium présente un taux de durcissement bien plus faible que le cuivre [5]. Ainsi, l'augmentation de la contrainte dans la céramique, au cours de la répétition des cycles thermiques, est réduite dans le cas de métallisation en aluminium, ce qui augmente de manière très significative la durée de vie du substrat.

Finalement, l'utilisation de céramique  $\text{Si}_3\text{N}_4$  est une solution également très attractive pour améliorer la durée de vie du substrat isolant dans le cas de cycles thermiques de grande amplitude. La limite de rupture mécanique de la céramique  $\text{Si}_3\text{N}_4$  est bien plus élevée que celle de l' $\text{AlN}$  permettant de repousser l'apparition de fracture conchoïdale. Ainsi, aucune défaillance n'a été relevée pour la solution AMB, avec une céramique  $\text{Si}_3\text{N}_4$  (VT 5), après plus de 700 cycles. Ce dernier résultat démontre clairement l'intérêt d'utiliser des céramiques présentant une limite de rupture mécanique élevée.

## V. DELAMINATION DE LA BRASURE :

L'initiation et la propagation de la fracture dans la brasure, au cours de la répétition des cycles thermiques, est principalement le résultat de la différence des coefficients de

dilatation thermique entre la semelle et l'ensemble qui compose le substrat isolant (métallisations et céramique).

La semelle ( $\text{AlSiC}$ ) et la brasure sont identiques pour l'ensemble des véhicules de test. Les différents échantillons testés nous permettent d'observer l'influence de la nature de la céramique et des métallisations sur la durée de vie de la brasure.

L'étude expérimentale réalisée peut ainsi permettre de comparer l'apparition de la délamination dans la brasure pour les différents véhicules de test. A titre d'exemple, les résultats de l'analyse acoustique présentés dans la figure 8 rendent compte de l'initiation puis de la propagation de la délamination dans la brasure du VT6.

On constate pour ce véhicule de test particulier que la délamination de la brasure apparaît préférentiellement dans l'angle inférieur droit. L'analyse acoustique en mode B-Scan, présentée dans la figure 9, permet d'évaluer qualitativement l'épaisseur de la brasure sous chacun des substrats céramiques du VT6. Cette analyse montre clairement que la délamination de la brasure s'initie prioritairement dans la zone où la brasure présente la plus faible épaisseur, résultat déjà bien connu [6,7].

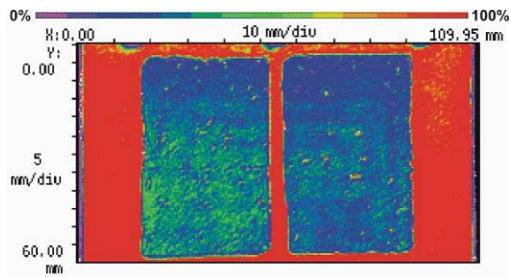
En raison de la dépendance significative de la durée de vie de la brasure avec l'épaisseur de la brasure, il pourra être relativement difficile de comparer l'ensemble des véhicules de test. Néanmoins, nous pouvons comparer l'influence de la surface des substrats sur l'intégrité de la brasure, sous réserve d'un contrôle de l'épaisseur de la brasure là où s'initie la délamination.

Un module préalablement testé dans des conditions de contraintes similaires [3], avec des dimensions de substrats élevées ( $5.08 \times 5.08 \text{ cm}^2$ ), a présenté une initiation de délamination de la brasure après seulement 90 cycles thermiques. Le VT3, avec des matériaux équivalent et une dimension des substrats plus faible ( $2.54 \times 3.70 \text{ cm}^2$ ), présente quant à lui une initiation de la délamination après 300 cycles. Cette constatation démontre, en accord avec de précédentes études [6,8], l'influence de la surface de la brasure, et donc celle du substrat céramique sur la tenue au cyclage thermique de la brasure.

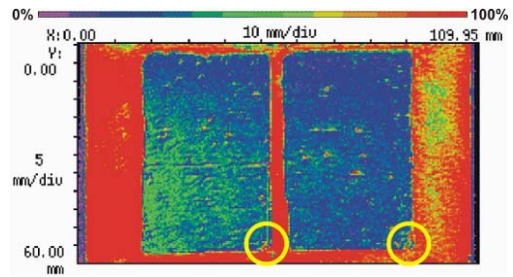
L'épaisseur de la métallisation des substrats DCB (côté semelle) est un autre paramètre influent. La différence entre le VT7 et le VT8 est uniquement relative à l'épaisseur de la métallisation en cuivre sur une céramique  $\text{AlN}$ , respectivement de  $127\mu\text{m}$  et  $200\mu\text{m}$ . Les résultats sont présentés dans la figure 10, où nous pouvons observer une initiation de la délamination de la brasure du VT8 après 140 cycles seulement. Aucune délamination n'est observée pour le VT7, présentant une métallisation d'épaisseur plus réduite, après 300 cycles.

Enfin, nous pouvons apprécier le très bon comportement du VT 2, présentant des dimples sur la métallisation inférieure du substrat. Aucune initiation de délamination n'a été observée après 778 cycles thermiques (cf. Fig. 11). Les dimples semblent là aussi présenter le même effet que celui d'une réduction locale de l'épaisseur de la métallisation.

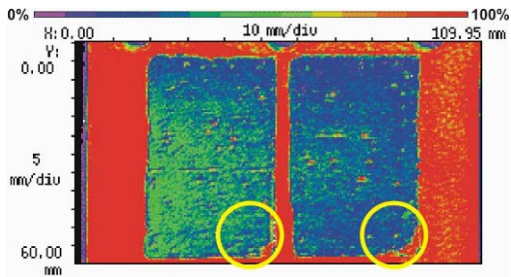
Ainsi, l'effet positif des dimples sur la durée de vie de l'assemblage, clairement démontré pour le cas de la fracture de la céramique, semble également s'appliquer sur la brasure, et retardant significativement l'apparition de la délamination.



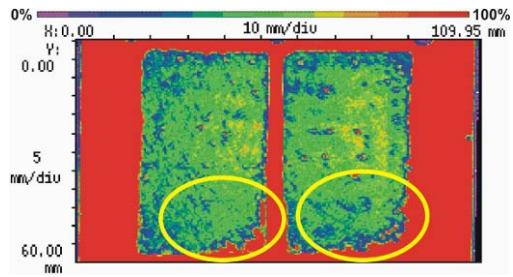
Avant le cyclage.



Après 40 cycles thermiques.



Après 190 cycles thermiques.



Après 500 cycles thermiques.

Figure 8 : Evaluation de la délamination de la brasure pour le VT 6 par microscopie acoustique

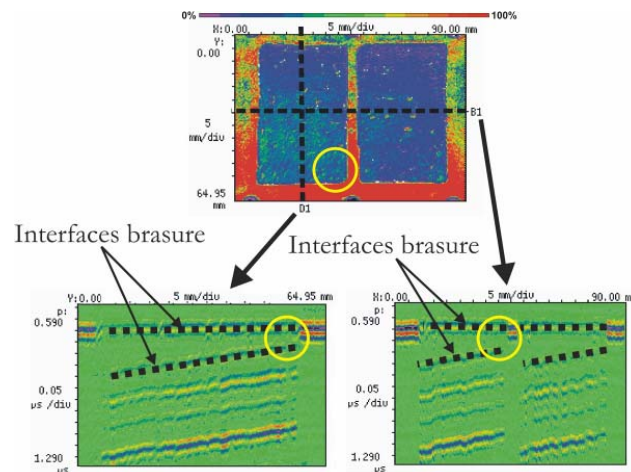
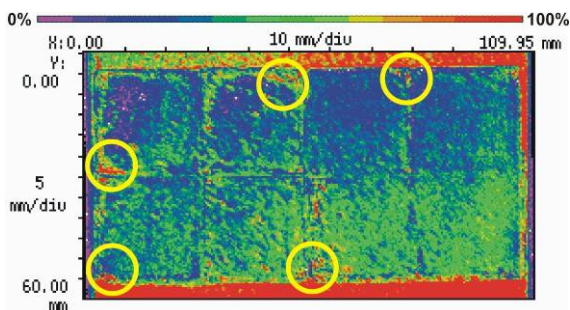
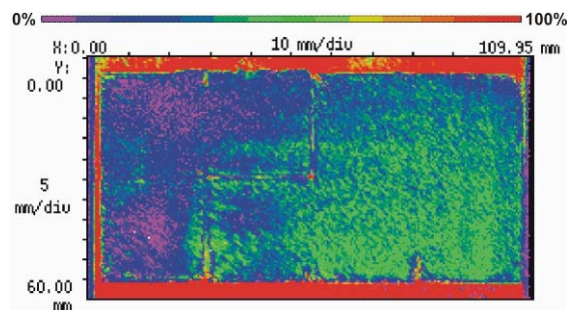


Figure 9 : Variation de l'épaisseur de la brasure.



VT8 après 140 cycles (Cu : 200 μm).



VT7 après 300 cycles (Cu : 127 μm).

Figure 10 : Influence de l'épaisseur de la métallisation sur le nombre de cycles avant initiation de la délamination.

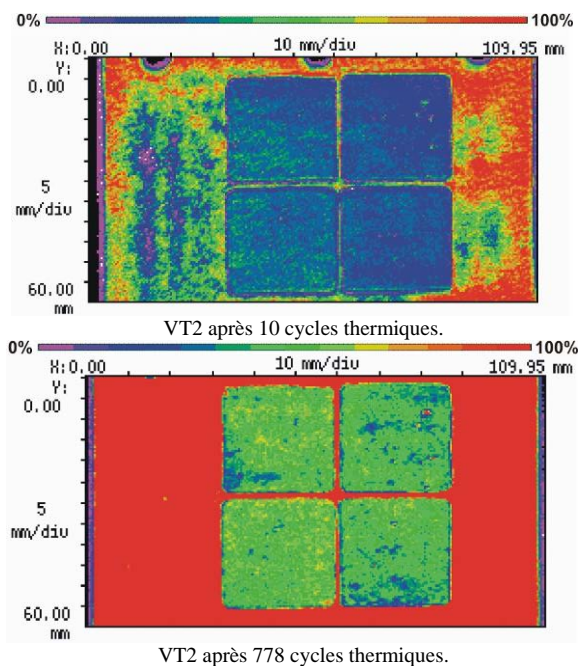


Figure 11 : Effet positif de la présence de dimples sur la métallisation inférieure du substrat DCB.

## VI. CONCLUSION :

Cette étude présente principalement des résultats expérimentaux sur la durée de vie de différentes technologies d'assemblage de puissance soumis à des cycles thermiques de grande amplitude jusqu'à haute température.

Différents véhicules de test mettant en œuvre des solutions technologiques différentes ont été étudiés. Deux principaux modes de défaillance ont été investigués, la fracturation de la céramique des substrats (DCB, AMB  $\text{Si}_3\text{N}_4$  et DAB), et la délamination de la brasure située entre la semelle  $\text{AlSiC}$  et le substrat céramique.

La fracture conchoïdale de la céramique provient du durcissement des métallisations et est initiée lorsque le niveau des contraintes mécaniques dépasse le seuil de rupture de la céramique. Nous avons pu montrer, dans le cas de substrats DCB (métallisations en cuivre), que la durée de vie du substrat céramique était considérablement augmentée en réduisant l'épaisseur des métallisations en cuivre. Ainsi, pour améliorer la durée de vie d'un tel assemblage, l'épaisseur de la métallisation doit être réduite au mieux, en adéquation avec le niveau de densité de courant acceptable pour les conducteurs réalisés. Les dimples, placés à la périphérie des métallisations, reproduisent l'effet obtenu lors d'une réduction locale de l'épaisseur des métallisations en cuivre, conduisant à augmenter la durée de vie des substrats céramique.

Des résultats analogues (pas de défaillance après plus de 700 cycles  $-30^\circ\text{C} / +180^\circ\text{C}$ ) sont obtenus avec le substrat céramique type DAB. La limite élastique de l'aluminium est plus faible que celle du cuivre, mais surtout, l'érouissage de l'aluminium est négligeable (taux de durcissement de l'aluminium bien plus faible que celui du cuivre). Ainsi, la répétition des cycles n'entraîne pas d'augmentation des contraintes reportées dans la céramique comme cela pouvait être le cas avec des métallisations en cuivre.

La céramique  $\text{Si}_3\text{N}_4$  semble également très attractive en raison de sa résistance mécanique élevée. Malgré le durcissement du cuivre, et donc l'augmentation des contrain-

tes dans la céramique lors de la répétition des cycles de température, nous n'avons pas constaté avec une céramique  $\text{Si}_3\text{N}_4$  d'apparition de fracture après plus de 700 cycles également.

Nous avons également cherché lors de cette étude à étudier la délamination de la brasure, induite par les différences de coefficient de dilatation thermique entre la semelle et les matériaux du substrat céramique. Nous avons pu constater que la durée de vie de la brasure était considérablement augmentée pour des substrats céramiques de plus faibles dimensions. Mais l'initiation de la délamination (et donc la durée de vie de la brasure) semble également dépendre fortement de l'épaisseur de la métallisation du substrat céramique. Les dimples agissant comme une réduction localisée de l'épaisseur du cuivre des DCB leur effet est donc également extrêmement bénéfique sur la durée de vie de la brasure.

## VII. REFERENCES :

- [1] G. Mitic, R. Beinert, and al., "Reliability of AlN Substrates and their Solder Joints in IGBT Power Modules", *Microelectronics Reliability*, 1999, Vol. 39, p. 1159-1164.
- [2] J. Schulz-Harder, "Advantages and New Development of direct Bonded Copper Substrates", *Microelectronics Reliability*, 2003, Vol. 43, p. 359-365.
- [3] L. Dupont & al. "Electrical Characterizations and evaluation of thermo-mechanical stresses of a power module dedicated to high temperature applications" *proceedings of EPE 2005, Dresde, September 2005*.
- [4] J. Schulz-Harder, "Direct Copper Bonded Substrates for Semiconductor Power Devices", *Curamik*.
- [5] Y. Nagatomo and T. Nagase, "The Study of the "Power Modules with High Reliability for EV Use", *Conference 17th EVS, Montreal, October 2000*.
- [6] E. Woïgard, Thèse, "Contribution à l'étude d'une intégration hybride adaptée à l'électronique automobile", 1992, Bordeaux 1.
- [7] J. Yamada, T. Simizu, et al., "the latest High Performance and High Reliability in New packages with Conventional Pin Layout", *Conférence PCIM, 2004*.
- [8] M. Ciappa, "Selected Failure Mechanisms of Modern power Modules" , *Microelectronics Reliability*, Vol. 42, 2002, pages : 653-667.